

SmartLED® White Hyper-Bright LED

LW L88S



Abgekündigt nach OS-PD-2005-003
Obsolete acc. to OS-PD-2005-003

Besondere Merkmale

- **Gehäusotyp:** SMT Gehäuse SCD 80, farbiger diffuser Verguss
- **Besonderheit des Bauteils:** kleinste Bauform 1,7 x 0,8 x 0,65 mm (LxBxH)
- **Farbort:** x = 0,33, y = 0,33 nach CIE 1931 (weiß)
- **typische Farbtemperatur:** 5600 K
- **Farbwiedergabeindex:** 80
- **Abstrahlwinkel:** horizontal 170°, vertikal 130°
- **Technologie:** InGaN
- **optischer Wirkungsgrad:** 4 lm/W
- **Gruppierungsparameter:** Lichtstärke, Farbort
- **Verarbeitungsmethode:** für alle SMT-Bestücktechniken geeignet
- **Lötmethode:** IR Reflow Löten und Wellenlöten (TTW)
- **Vorbehandlung:** nach JEDEC Level 2
- **Gurtung:** 8-mm Gurt mit 5000/Rolle, ø180 mm
- **ESD-Festigkeit:** ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-B

Anwendungen

- flache Hinterleuchtung (LCD, Mobile Phone, Schalter, Display)
- Spielsachen
- Signal- und Symbolleuchten
- Markierungsbeleuchtung (Stufen, Fluchtwege u. ä.)

Features

- **package:** SMT package SCD 80, colored diffused resin
- **feature of the device:** smallest package 1.7 x 0.8 x 0.65 mm (LxWxH)
- **color coordinates:** x = 0.33, y = 0.33 acc. to CIE 1931 (white)
- **typ. color temperature:** 5600 K
- **color reproduction index:** 80
- **viewing angle:** horizontal 170°, vertical 130°
- **technology:** InGaN
- **optical efficiency:** 4 lm/W
- **grouping parameter:** luminous intensity, color coordinates
- **assembly methods:** suitable for all SMT assembly methods
- **soldering methods:** IR reflow soldering and TTW soldering
- **preconditioning:** acc. to JEDEC Level 2
- **taping:** 8 mm tape with 5000/reel, ø180 mm
- **ESD-withstand voltage:** up to 2 kV acc. to JESD22-A114-B

Applications

- flat backlighting (LCD, cellular phones, switches, displays)
- toys
- signal and symbol luminary
- marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)

Bestellinformation
Ordering Information

Typ	Emissions- farbe	Lichtstärke ¹⁾ Seite 16	Lichtstrom ²⁾ Seite 16	Bestellnummer
Type	Color of Emission	Luminous Intensity ¹⁾ page 16 $I_F = 10 \text{ mA}$ $I_V \text{ (mcd)}$	Luminous Flux ²⁾ page 16 $I_F = 10 \text{ mA}$ $\Phi_V \text{ (mlm)}$	Ordering Code
■ LW L88S-L1M1-35	white	11.2 ...22.4	65 (typ.)	Q65110A0048
■ LW L88S-M1N2-35		18.0 ...45.0	120 (typ.)	Q65110A0046
■ LW L88S-N2P2-35		35.5 ...71.0	210 (typ.)	Q65110A0044
■ LW L88S-L1M1-25	white	11.2 ...22.4	65 (typ.)	on request
■ LW L88S-M1N2-25		18.0 ...45.0	120 (typ.)	on request
■ LW L88S-N2P2-25		35.5 ...71.0	210 (typ.)	on request

- Abgekündigt nach OS-PD-2005-003 - werden durch LW L28S RoHS Compliant ersetzt werden
 Obsolete acc. to OS-PD-2005-003 - will be replaced by LW L28S RoHS Compliant
 Letzte Bestellung / Last Order: 2005-08-31
 Letzte Lieferung / Last Delivery: 2006-02-28

Anm.: **-25** Farbselektiert nach Farbortgruppen, Lieferung in Einzelgruppen(siehe **Seite 5**)

Note: **-25** Color selection acc. to chromaticity coordinate groups, delivery in single groups (see **page 5**)

Grenzwerte
Maximum Ratings

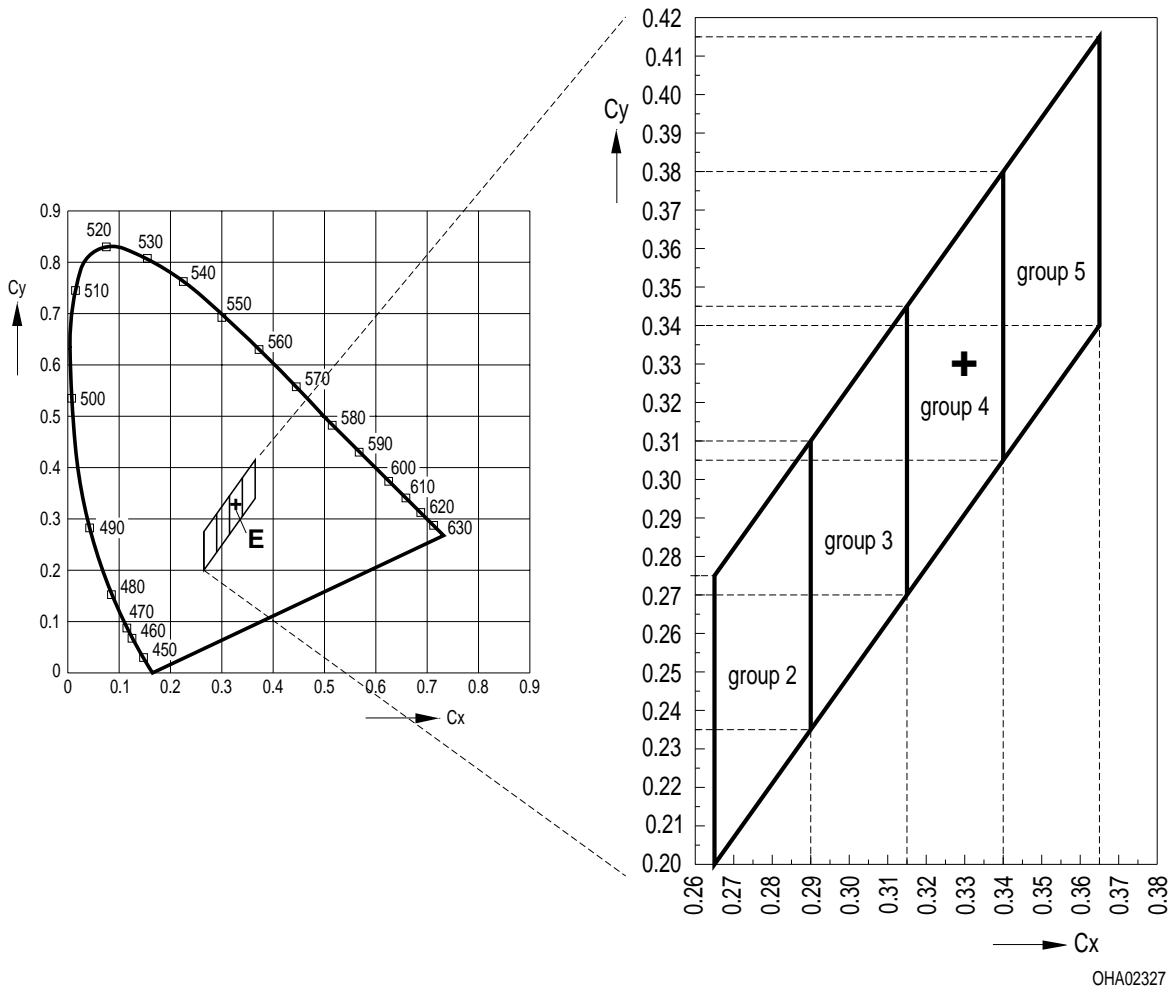
Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Betriebstemperatur Operating temperature range	T_{op}	- 40 ... + 100	°C
Lagertemperatur Storage temperature range	T_{stg}	- 40 ... + 100	°C
Sperrschichttemperatur Junction temperature	T_j	+ 100	°C
Durchlassstrom Forward current ($T_A=25^\circ\text{C}$)	I_F	15	mA
Stoßstrom Surge current $t \leq 10 \mu\text{s}$, $D = 0.005$, $T_A=25^\circ\text{C}$	I_{FM}	150	mA
Sperrspannung ³⁾ Seite 16 Reverse voltage ³⁾ page 16 ($T_A=25^\circ\text{C}$)	V_R	5	V
Leistungsaufnahme Power consumption ($T_A=25^\circ\text{C}$)	P_{tot}	60	mW
Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Umgebung ⁴⁾ Seite 16 Junction/ambient ⁴⁾ page 16	$R_{th JA}$	450	K/W
Sperrschicht/Löt看 Junction/solder point	$R_{th JS}$	260	K/W

Kennwerte
Characteristics
 $(T_A = 25\text{ °C})$

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Farbkoordinate x nach CIE 1931 ⁵⁾ Seite 16 (typ.) Chromaticity coordinate x acc. to CIE 1931 ⁵⁾ page 16 $I_F = 10\text{ mA}$	x	0.33*	–
Farbkoordinate y nach CIE 1931 ⁵⁾ Seite 16 (typ.) Chromaticity coordinate y acc. to CIE 1931 ⁵⁾ page 16 $I_F = 10\text{ mA}$	y	0.33*	–
Abstrahlwinkel bei 50 % I_V (Vollwinkel) (typ.) Viewing angle at 50 % I_V	2ϕ	170 (horizontal) 130 (vertical)	Grad deg.
Durchlassspannung ⁶⁾ Seite 16 (typ.) Forward voltage ⁶⁾ page 16 (max.) $I_F = 10\text{ mA}$	V_F V_F	3.4 3.8	V V
Sperrstrom (typ.) Reverse current (max.) $V_R = 5\text{ V}$	I_R I_R	0.01 10	μA μA
Temperaturkoeffizient von x (typ.) Temperature coefficient of x $I_F = 10\text{ mA}; -10\text{ °C} \leq T \leq 100\text{ °C}$	TC_x	–0.1	$10^{-3}/\text{K}$
Temperaturkoeffizient von y (typ.) Temperature coefficient of y $I_F = 10\text{ mA}; -10\text{ °C} \leq T \leq 100\text{ °C}$	TC_y	–0.2	$10^{-3}/\text{K}$
Temperaturkoeffizient von V_F (typ.) Temperature coefficient of V_F $I_F = 10\text{ mA}; -10\text{ °C} \leq T \leq 100\text{ °C}$	TC_V	–3.1	mV/K
Optischer Wirkungsgrad (typ.) Optical efficiency $I_F = 10\text{ mA}$	η_{opt}	4	lm/W

* Einzelgruppen siehe Seite 5
Individual groups on page 5

Farbortgruppen⁵⁾ Seite 16
 Chromaticity Coordinate Groups⁵⁾ page 16



Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups

Helligkeitshalbgruppe Brightness Half Group	Lichtstärke ¹⁾ Seite 16 Luminous Intensity ¹⁾ page 16 I_V (mcd)	Lichtstrom ²⁾ Seite 16 Luminous Flux ²⁾ page 16 Φ_V (mlm)
L1	11.2 ... 14.0	50 (typ.)
L2	14.0 ... 18.0	60 (typ.)
M1	18.0 ... 22.4	80 (typ.)
M2	22.4 ... 28.0	100 (typ.)
N1	28.0 ... 35.5	130 (typ.)
N2	35.5 ... 45.0	160 (typ.)
P1	45.0 ... 56.0	200 (typ.)
P2	56.0 ... 71.0	250 (typ.)

Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus 3 bzw. 4 Helligkeitshalbgruppen. Einzelne Helligkeitshalbgruppen sind nicht bestellbar.

Note: The standard shipping format for serial types includes a lower or upper family group of 3 or 4 individual brightness half groups. Individual brightness half groups cannot be ordered.

Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label

Beispiel: M2-4

Example: M2-4

Helligkeitshalbgruppe Brightness Half Group	Farbortgruppe Chromaticity Coordinate Group
M2	4

Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.

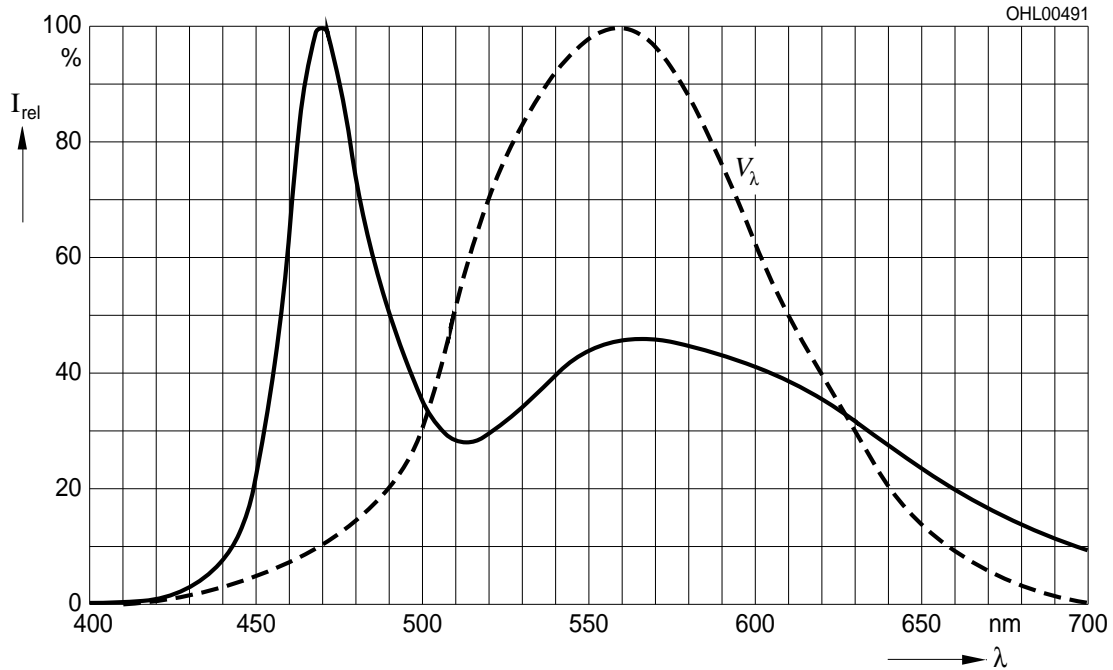
Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.

Relative spektrale Emission²⁾ Seite 16

Relative Spectral Emission²⁾ page 16

$V(\lambda)$ = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve

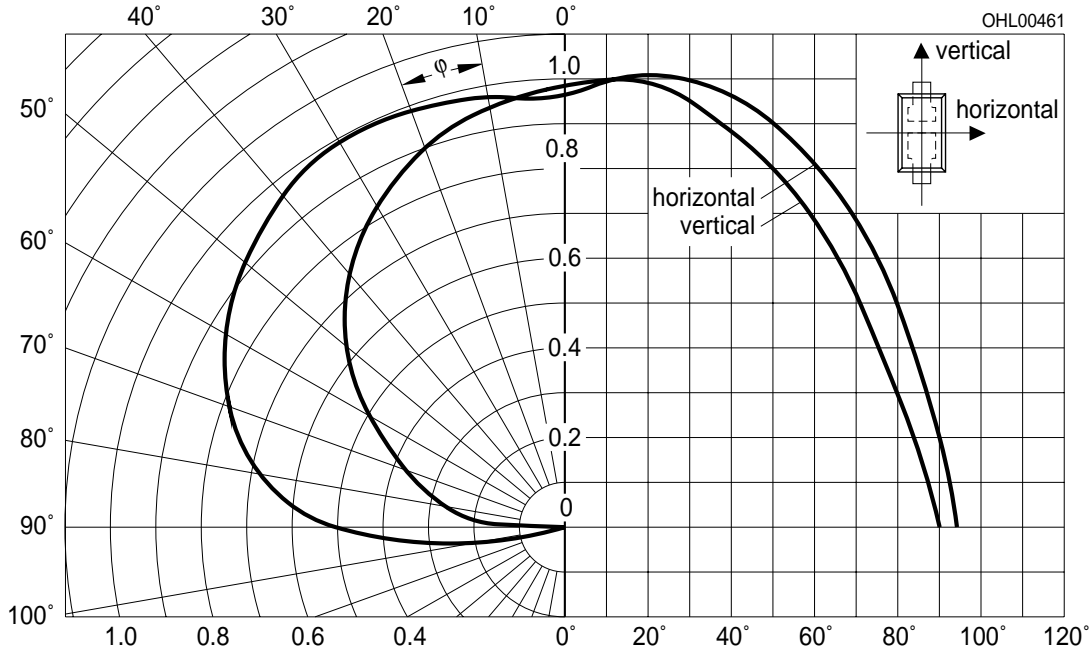
$I_{rel} = f(\lambda)$; $T_A = 25\text{ }^\circ\text{C}$; $I_F = 10\text{ mA}$



Abstrahlcharakteristik²⁾ Seite 16

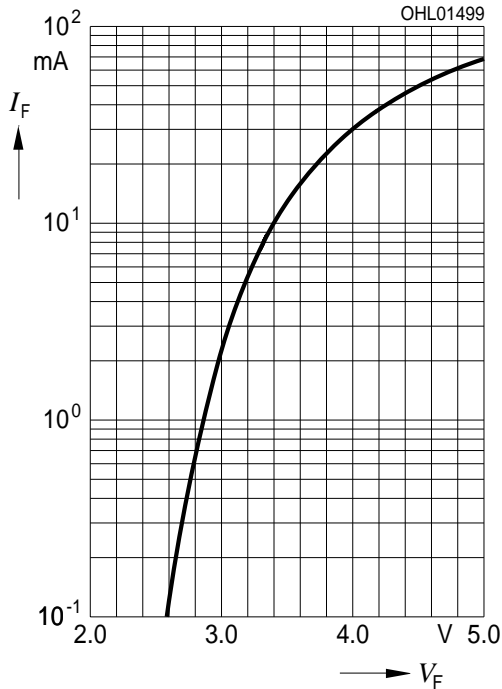
Radiation Characteristic²⁾ page 16

$I_{rel} = f(\varphi)$



Durchlassstrom²⁾ Seite 16
Forward Current²⁾ page 16

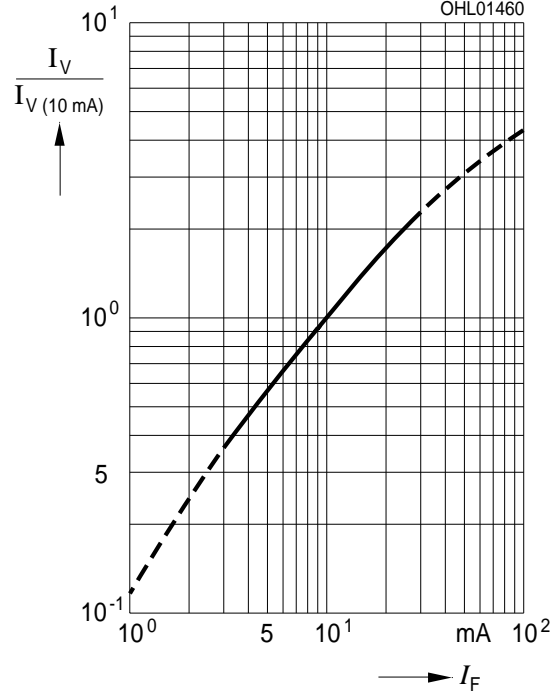
$I_F = f(V_F); T_A = 25\text{ }^\circ\text{C}$



Relative Lichtstärke^{2) 7)} Seite 16

Relative Luminous Intensity^{2) 7)} page 16

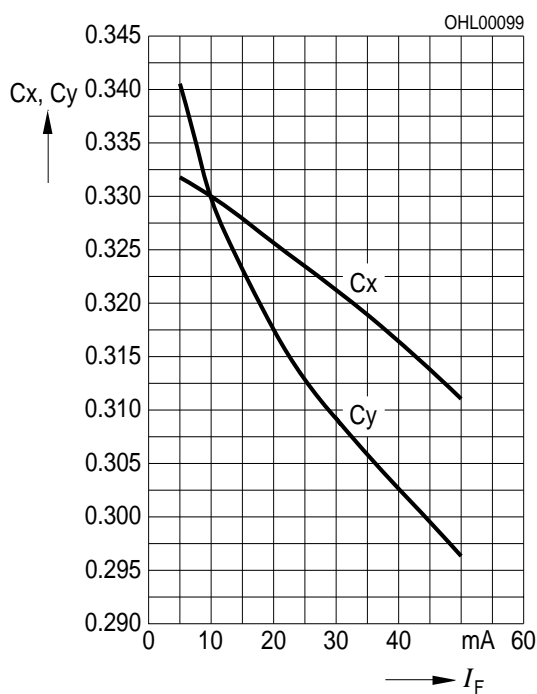
$I_V/I_{V(10\text{ mA})} = f(I_F); T_A = 25\text{ }^\circ\text{C}$



Farbortverschiebung²⁾ Seite 16

Chromaticity Coordinate Shift²⁾ page 16

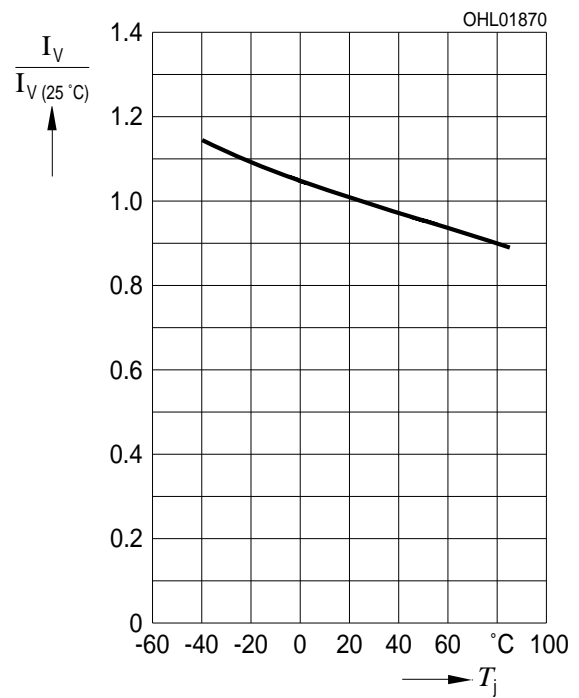
$x, y = f(I_F); T_A = 25\text{ }^\circ\text{C}$



Relative Lichtstärke²⁾ Seite 16

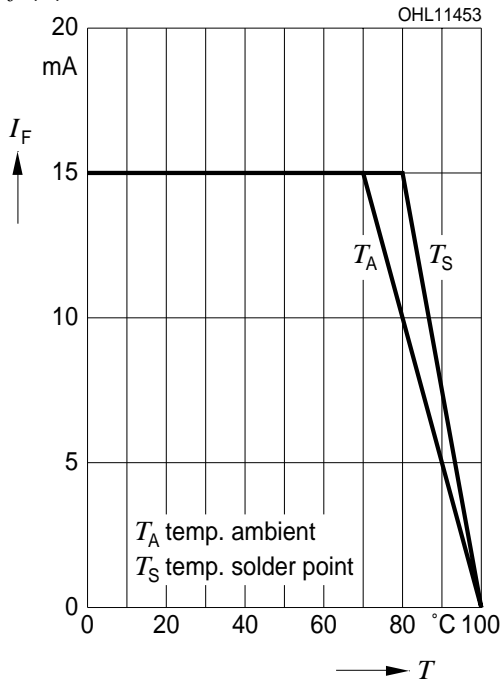
Relative Luminous Intensity²⁾ page 16

$I_V/I_{V(25\text{ }^\circ\text{C})} = f(T_j); I_F = 10\text{ mA}$

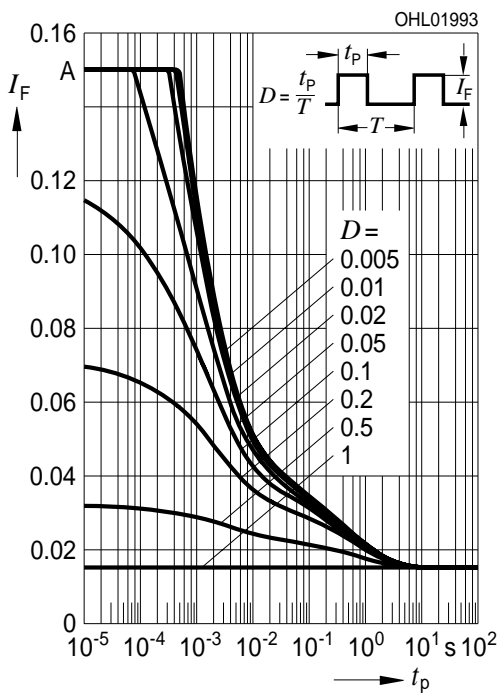


Maximal zulässiger Durchlassstrom
Max. Permissible Forward Current

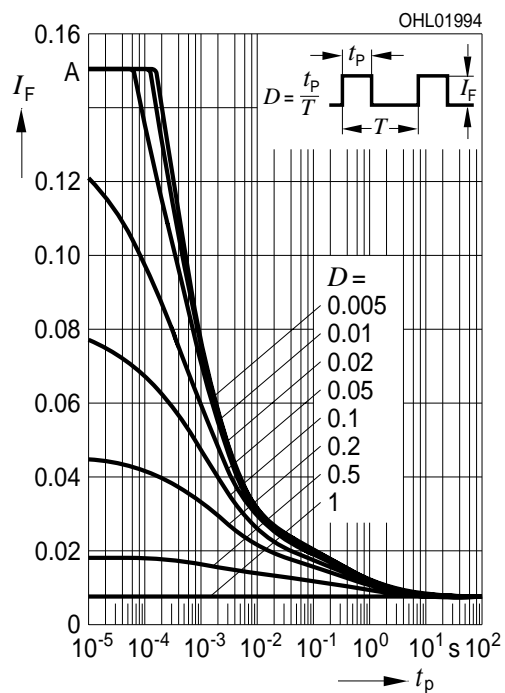
$I_F = f(T)$



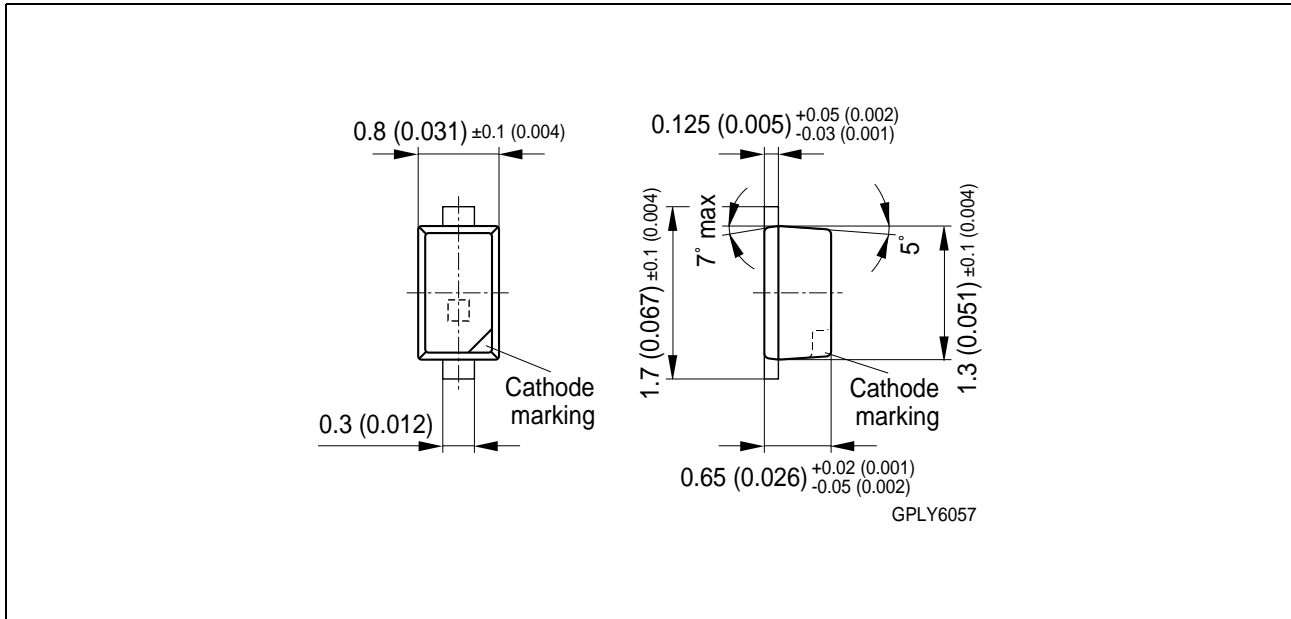
Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$
Permissible Pulse Handling Capability
 Duty cycle $D =$ parameter, $T_A = 25$ °C



Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$
Permissible Pulse Handling Capability
 Duty cycle $D =$ parameter, $T_A = 85$ °C



Maßzeichnung⁸⁾ Seite 16
 Package Outlines⁸⁾ page 16



Gewicht / Approx. weight:

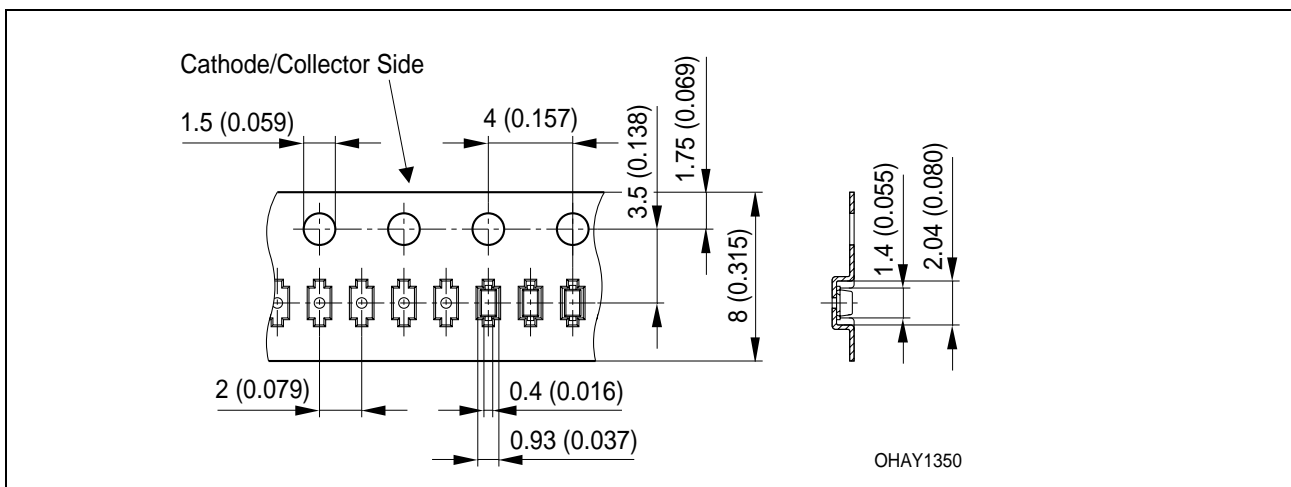
1.4 mg

Gurtung / Polarität und Lage⁸⁾ Seite 16

Verpackungseinheit 8 mm Gurt mit 5000/Rolle,
 $\varnothing 180$ mm

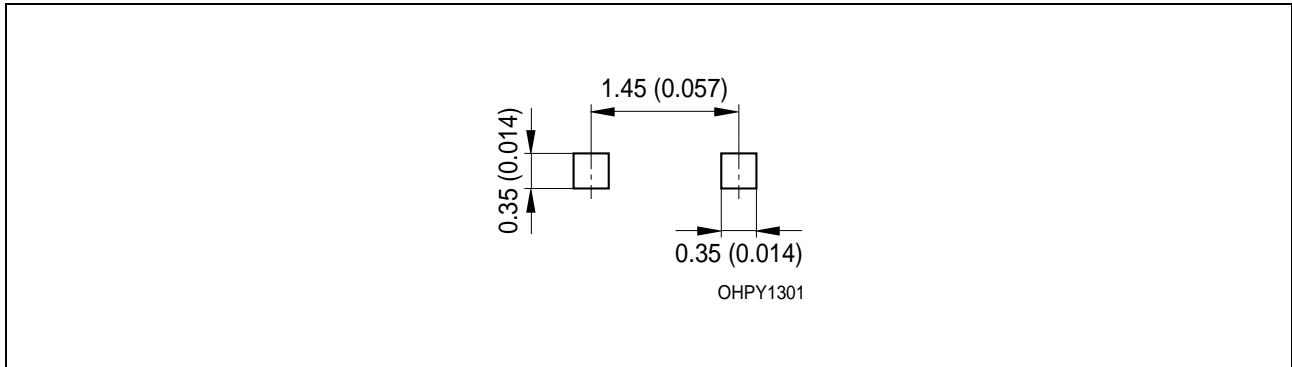
Method of Taping / Polarity and Orientation⁸⁾ page 16

Packing unit 8 mm tape with 5000/reel,
 $\varnothing 180$ mm



Empfohlenes Lötpadding^{8) 9)} Seite 16
Recommended Solder Pad^{8) 9)} page 16

IR Reflow Lötén
 IR Reflow Soldering

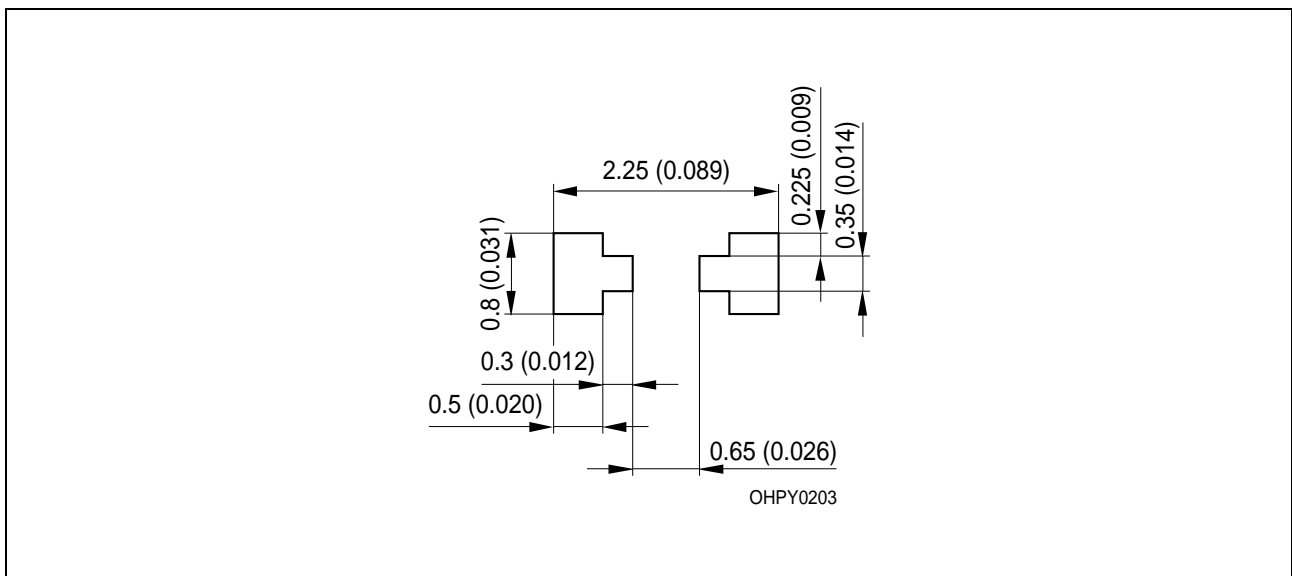


Empfohlenes Lötpadding verwendbar für SmartLED® und Chiplid - Bauform 0603

IR Reflow Lötén^{8) 9) 10)} Seite 16

Recommended Solder Pad useable for SmartLED® and Chiplid - Package 0603

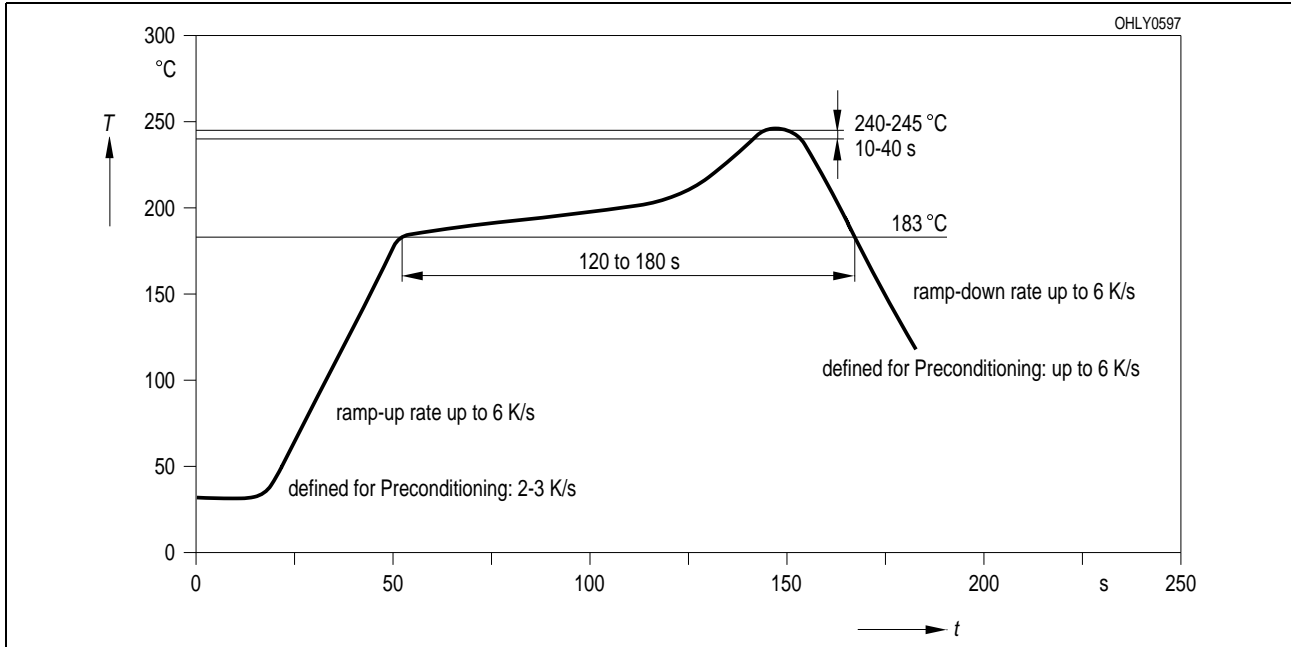
IR Reflow Soldering^{8) 9) 10)} page 16



Lötbedingungen
Soldering Conditions

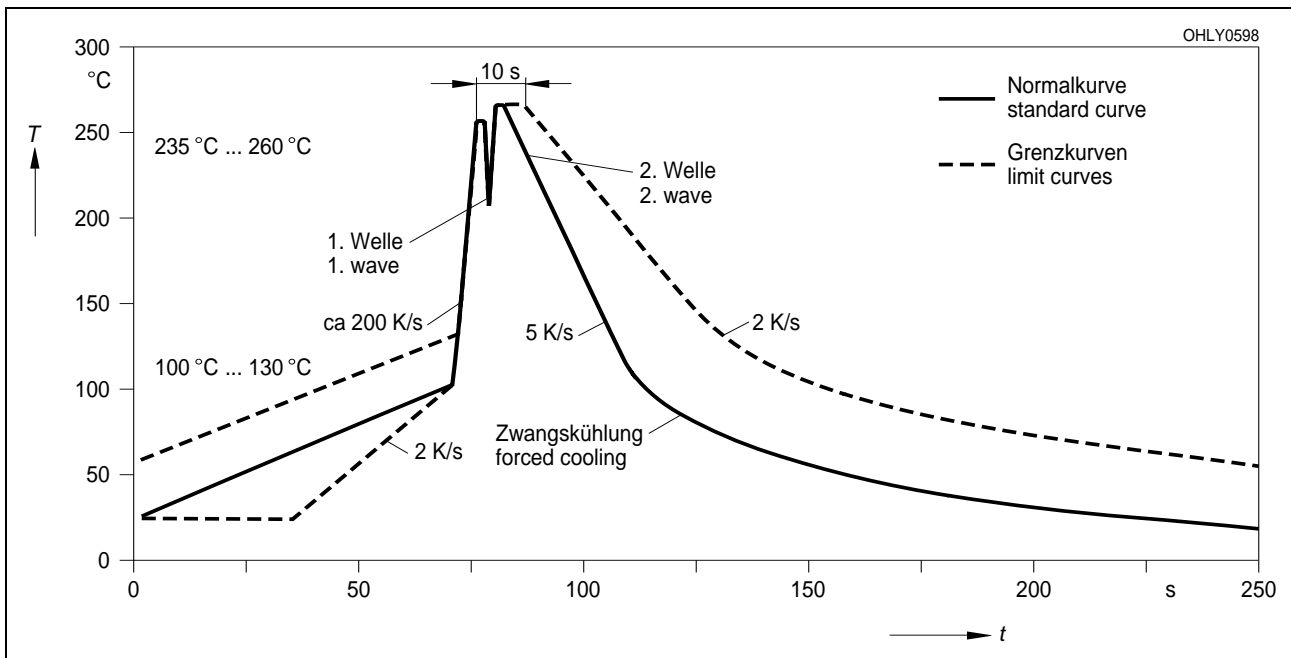
IR-Reflow Lötprofil
IR Reflow Soldering Profile

Vorbehandlung nach JEDEC Level 2
Preconditioning acc. to JEDEC Level 2
(nach IPC 9501)
(acc. to IPC 9501)



Wellenlöten (TTW)
TTW Soldering

(nach CECC 00802)
(acc. to CECC 00802)



Barcode-Produkt-Etikett (BPL)
Barcode-Product-Label (BPL)

OSRAM Opto Semiconductors

Lx.xxxx Bin1: Bin Information Color 1
 Product Name Bin2:
 Bin3:

(6P) BATCH NO: Batch Number
Bar Code

ML Temp ST
 2 245 C R
 2 260 C T

(1T) LOT NO: Lot Number (9D) D/C: Date Code
Bar Code

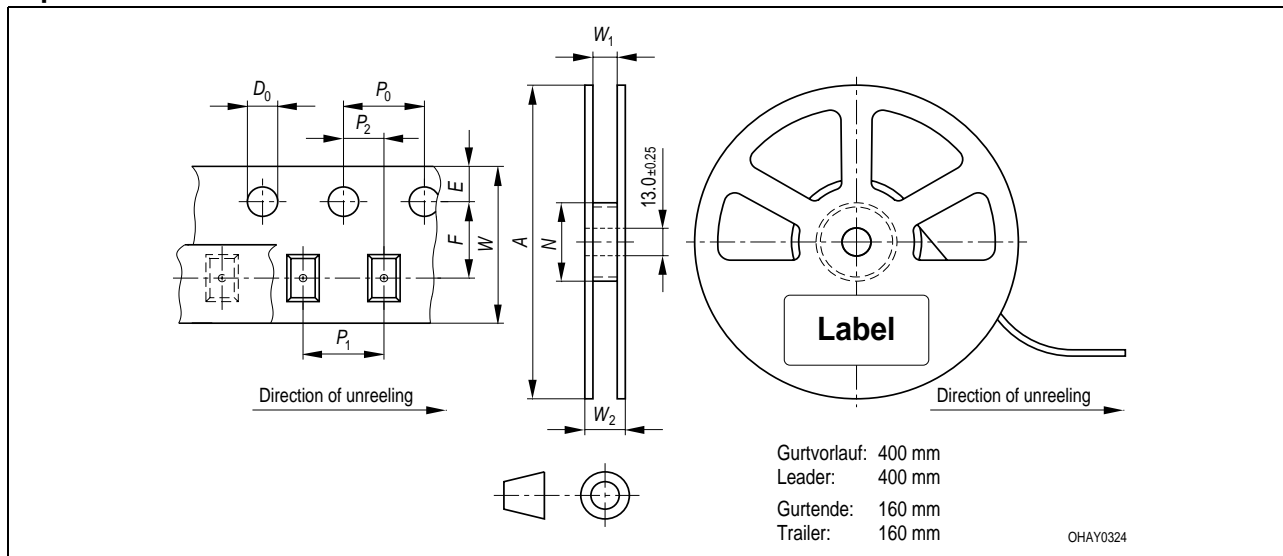
Additional TEXT
 R077 DEMY
 PACKVAR: Packing Type

(X) PROD NO: Product Code (Q)QTY: Product Quantity per Reel (G) GROUP: X - X - X
Bar Code

Forward Voltage Rank
 Wavelength Rank
 Brightness Rank

OHA02043

Gurtverpackung
Tape and Reel



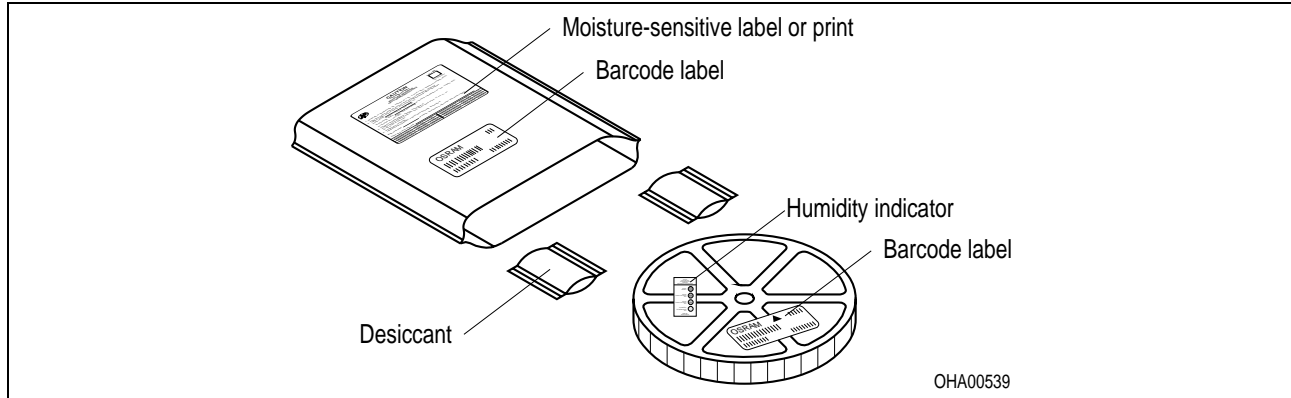
Tape dimensions in mm (inch)

W	P ₀	P ₁	P ₂	D ₀	E	F
8 + 0.3 - 0.1	4 ± 0.1 (0.157 ± 0.004)	4 ± 0.1 (0.157 ± 0.004)	2 ± 0.05 (0.079 ± 0.002)	1.5 + 0.1 (0.059 + 0.004)	1.75 ± 0.1 (0.069 ± 0.004)	3.5 ± 0.05 (0.138 ± 0.002)

Reel dimensions in mm (inch)

A	W	N _{min}	W ₁	W _{2 max}
180 (7)	8 (0.315)	60 (2.362)	8.4 + 2 (0.331 + 0.079)	14.4 (0.567)

Trockenverpackung und Materialien Dry Packing Process and Materials



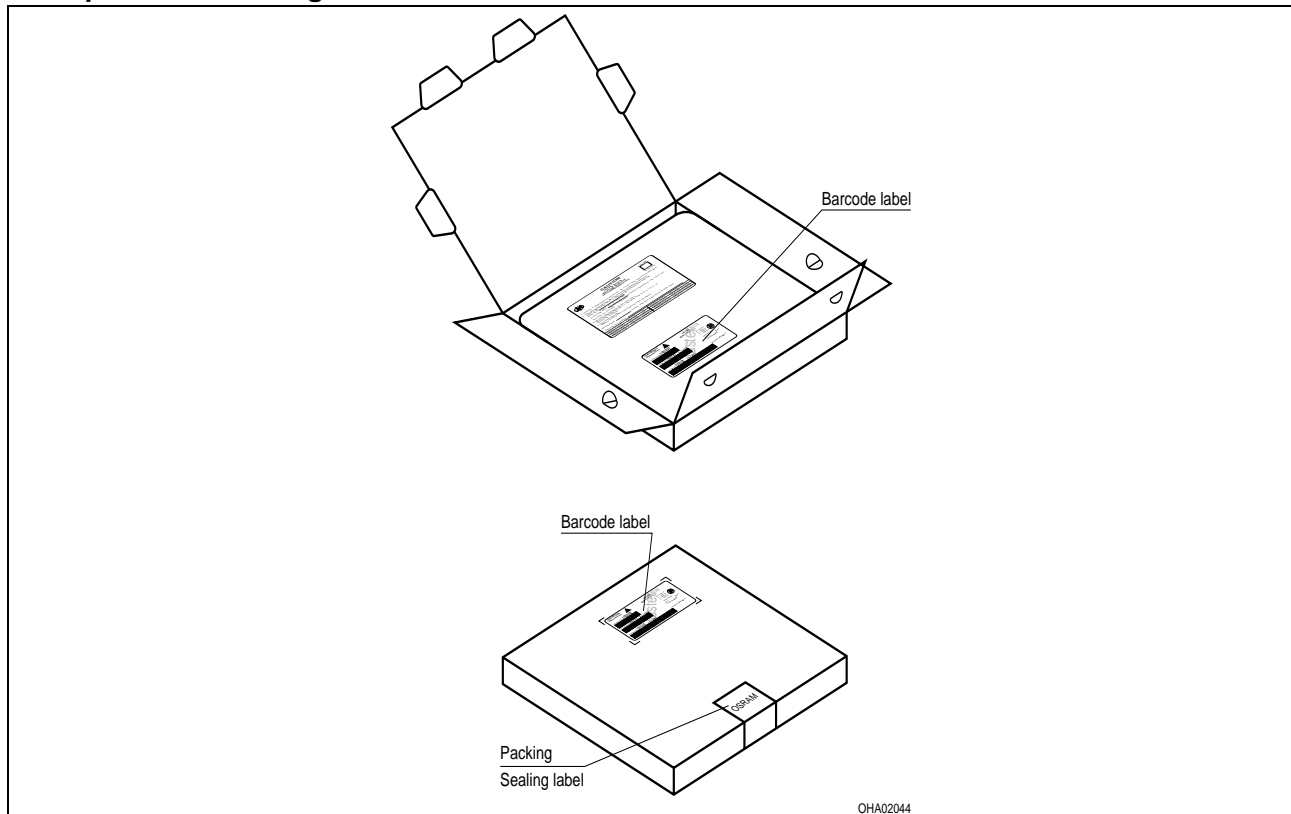
Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte

Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel "Gurtung und Verpackung" unter dem Punkt "Trockenverpackung". Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.

Note: Moisture-sensitive product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.

Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter "Tape and Reel" under the topic "Dry Pack". Here you will also find the normative references like JEDEC.

Kartonverpackung und Materialien Transportation Packing and Materials



Revision History: 2005-03-02

Previous Version: 2004-06-28

Page	Subjects (major changes since last revision)	Date of change
13	recommended solder pad	
2	color coordinate grouping for white	
3	pad size from 16 mm ² to 5 mm ²	
2	ordering code inserted	
8	Max. Permissible Forward Current	2002-08-21
15	annotations	2002-07-25
3	reverse voltage (footnote)	2002-08-21
2, 5	color coordinate grouping	2002-11-04
1, 14	tape with 5000/reel	2002-11-22
8	diagram max. perm. forward current	2003-06-16
8	new pulse derating	2003-06-26
3	ambient temperature	2003-09-16
1	ESD-withstand voltage	2003-09-16
15	new patent no.	2003-09-17
all	not for new designs	2004-06-28
all	Product Discontinuation	2005-03-02

Patent List

Patent No.
US 6 066 861
US 6 277 301
US 6 245 259
US 6 576 930

Attention please!

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components¹¹⁾ page 16 may only be used in life-support devices or systems¹²⁾ page 16 with the express written approval of OSRAM OS.

2005-03-02

15

Fußnoten:

- 1) Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von $\pm 11\%$ ermittelt.
- 2) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
- 3) Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben werden.
- 4) Montage auf PC-Board FR 4 (Padgröße $\geq 5 \text{ mm}^2$ je Pad)
- 5) Farbortgruppen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von $\pm 0,01$ ermittelt.
- 6) Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von $\pm 0,1 \text{ V}$ ermittelt.
- 7) Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden.
- 8) Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch).
- 9) Gehäuse hält TTW-Löthitze aus.
- 10) Empfohlene Lötpastendicke: 120 μm
- 11) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.
- 12) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
 - (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder
 - (b) für die Lebenserhaltung bestimmt.
 Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

Remarks:

- 1) Brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of $\pm 11\%$.
- 2) Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice.
- 3) Driving the LED in reverse direction is suitable for short term application.
- 4) Mounted on PC board FR 4 (pad size $\geq 5 \text{ mm}^2$ per pad)
- 5) Chromaticity coordinate are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ± 0.01 .
- 6) Forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of $\pm 0.1 \text{ V}$.
- 7) In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit.
- 8) Dimensions are specified as follows: mm (inch).
- 9) Package able to withstand TTW-soldering heat.
- 10) Recommended thickness of solder paste: 120 μm
- 11) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.
- 12) Life support devices or systems are intended
 - (a) to be implanted in the human body,
 - or
 - (b) to support and/or maintain and sustain human life.
 If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

Published by
OSRAM Opto Semiconductors GmbH
 Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg
www.osram-os.com
 © All Rights Reserved.